

平成 25 年度化学工学会粒子・流体プロセス部会

ミキシング技術分科会夏期セミナー

「多様な分野で利用されるミキシング技術」

主催：公益社団法人化学工学会粒子・流体プロセス部会ミキシング技術分科会

共催：公益社団法人化学工学会関東支部，公益社団法人化学工学会開発型企業の会

日時：2013 年 8 月 26 日(月)，27 日(火)

会場：東京理科大学森戸記念館(〒162-0825 東京都新宿区神楽坂 4-2-2)

JR 飯田橋駅西口，東京メトロ飯田橋駅 B3 出口より徒歩 5 分，<http://www.tus.ac.jp/info/access/kagcamp.html>

プログラム

8 月 26 日(月)(講演は英語で行われます)

15:30-16:30 “What do we know about solids mixing?”

Professor Hsiu-Po Kuo, Chang Gung University, Taiwan

16:30-17:30 ”The Mixing Study Made of Supports of Formosa”

Professor Emeritus Kohei Ogawa, Tokyo Institute of Technology, Japan

18:00-20:00 懇親会

8 月 27 日(火)(講演は日本語で行われます)

10:00-11:15 「高分子材料の溶融混練」

九州大学

梶原稔尚氏

11:15-12:15 「粉体分散を伴う化粧品の新規製造プロセスの開発」(仮)

(株)資生堂リサーチセンター

那須昭夫氏

12:15-13:15 休憩

13:15-14:15 「配管軸方向の濃度ムラを低減する静止型ミキサにおける

CFD を用いた混合性能最適化」

旭有機材工業(株)

岡田貴弘氏

14:15-15:15 「超音波による攪拌効果を活用した化学プロセス」

東京理科大学

小林大祐氏

15:15-15:30 休憩

15:30-16:30 「食品の流体・ミキシング関連技術の紹介2題

①チーズの製造工程におけるインライン粘度計測

②連続式蒸気殺菌技術に関する研究と開発(食品工学会技術賞)」

サニタリー エンジニアリング コンサルタント 設楽英夫氏

●参加費(当日申し受けます)

化学工学会会員：¥13,000，学生会員：¥8,000，化学工学会会員以外：¥25,000

懇親会参加：¥7,000 別途申し受けます。

●申込方法

8 月 19 日(月)までに下記申込先までメールによりお申し込みください。その際以下項目を明記願います。

・ご指名，ご所属，E-meil アドレス，電話番号，・懇親会のご出欠，・化学工学会会員，非会員の別

●申込先(問合せ先)

東京工業大学大学院理工学研究科化学工学専攻 吉川史郎

E-mail: [syoshika@chemeng.titech.ac.jp](mailto:syoshika@chemeng.titech.ac.jp)

〒152-8552 東京都目黒区大岡山 2-12-1-S4-2, TEL.&FAX:03-5734-3278